



TG-A96AB / A96AB

熱伝導封止ゲル

REACH Compliant RoHS Compliant

製品特長

- ・ 材質はエポキシ樹脂で、硬度が高い
- ・ 硬化後、デバイスを外部の環境影響から保護出来

応用範囲

Electronic Components - 5G, Aerospace, AI, AIoT, AR/VR/MR/XR, Automotive, Consumer Devices, Datacom, Electric Vehicle, Electronic Products, Energy Storage, Industrial, Lighting Equipment, Medical, Military, Netcom, Panel, Power Electronics, Robot, Servers, Smart Home, Telecom, etc.

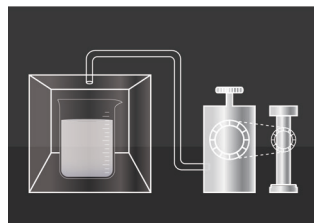
保管条件

未開封の状態です室温 25°C 以下に 12 ヶ月保存出来。

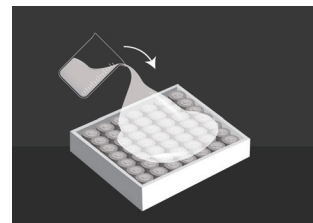
取扱説明書



① Mix component A and B.



② Vacuum out air.

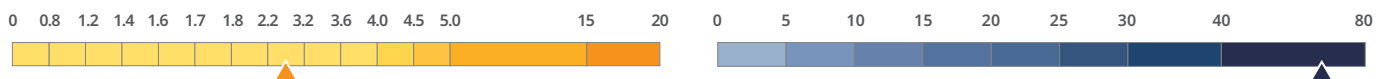


③ Pour potting compound.

製品物性

熱伝導率 : 2.6 W/m·K

硬さ : 68 (Shore A)



製品物性	単位	TG-A96AB / A96AB	公差	試験基準
熱伝導率	W/m·K	2.6	±0.25	ASTM D5470 Modified
色	-	White/Black	-	-
耐電圧	kV/mm	≥11	-	ASTM D149
重量減少	%	<1	-	By T-Global
密度	g/cm ³	2.5	±5%	ASTM D792
使用温度範囲	°C	-25~+150	-	-
粘性	Pa·s	1.8~2.5	-	Brookfield Viscometer
硬化時間 @25° C	hr	12	-	-
硬化時間 @80° C	hr	0.5	-	-
標準梱包	-	バケツ	-	-
硬さ	Shore A	68	±10	ASTM D2240
混合比	gram	13:1	-	-

▶エポキシ樹脂と熱伝導材料から作られた A 剤は密度の異なりにより層は成されます。そういう現象は普通ですので、ご安心ください。
使用する前にヘラ平型スクレーパーやステンレス製器具で A 剤をゆっくり混ぜ合わせてください。そうしたら優れた熱伝導効果を作れます。

T-Global Technology 株式会社

Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-4 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
T +81-3-6863-6387 E japan@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com

Version20
20250325



注意：本技術からのデータ情報は T-Global からの研究や検査により出てきた最も良い結果です。データ上の数は典型的な数字で、各バッチ製品を検査することではありません。もしスペックが変更されたら、別に通知することはありません。製品の効能に影響を与えられない保護フィルムが剥離紙と保護フィルムは製品の効率に影響を与えられません、特別な要望がなければ、T-Global の評価を基準にします。各種の可能な使用条件が弊社のコントロールできる範囲を超えることで、弊社は提出させていただきましたアドバイスは何の保証や責任が生じることがありません。ですので、お客様は製品を試しながら、弊社の製品が各種の条件で応用できるかどうかご確認ください。本製品を売買する時には何が特定のところで応用できることを保証することがありません。但し、本製品が T-Global とお互いに確認した invoice、お見積りやご注文に基づき、基準的な品質を提供させていただきます。我々は使用者がどのように本技術からのデータ情報を使うことに責任を持ちません。一方、本技術から生み出されたデータ情報は説明内容や製品に関する用途、未来特許衝突、工芸製造や製品の使用についてのアドバイスなどが含まれておりません。